

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-038
**斯达半导体股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2024年09月13日(星期五)上午09:00-10:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月06日(星期五)至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor-relation@powersemi.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月13日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2024年09月13日上午09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参加人员
董事长:总经理:沈华先生
董事会秘书:财务总监:张哲先生
独立董事:沈小军先生
- 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月13日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月06日(星期五)至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或希望通过公司邮箱investor-relation@powersemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0573-8286699
邮箱:investor-relation@powersemi.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

斯达半导体股份有限公司
2024年08月30日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-039

斯达半导体股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前,斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“斯达半导”)股东浙江兴得利的组织有限公司(以下简称“兴得利”)持有公司股份22,238,201股,占公司总股本比例为13.01%;公司副总经理戴志展持有公司股份599,204股,占公司总股本比例为0.35%;公司副总经理TANG YI(汤艺)持有公司股份377,500股,占公司总股本比例为0.22%。

2024年05月23日,公司实施了2023年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。前述3位减持主体在转增实施之前并未进行减持,因此转增后兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)的持股数量相应变更为31,133,481股、838,886股、528,500股。

● 减持计划的实施结果情况
公司于2024年05月07日在上海证券交易所网站披露了《斯达半导体股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号2024-023),兴得利计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过3,300,000股,即不超过公司总股本的1.93%;公司副总经理戴志展计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过90,000股,即不超过公司总股本的0.05%;公司副总经理TANG YI(汤艺)计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过50,000股,即不超过公司总股本的0.03%。其中,大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内,集中竞价交易方式减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,自上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项,减持股份的数量相应调整。

公司于2024年08月30日收到兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)发来的《关于股份减持结果的告知函》,2024年05月29日至2024年08月29日期间,兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)通过大宗交易和集中竞价的方式累计减持公司股份1,702,910股(占公司总股本的0.71%),本次减持计划已实施完毕,现将具体事项公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
兴得利	5%以上非第一大股东	31,133,481	13.01%	IPO前取得;22,237,701股其他方式取得;8,895,780股
戴志展	董事、监事、高级管理人员	838,886	0.35%	IPO前取得;599,204股其他方式取得;239,682股
TANG YI(汤艺)	董事、监事、高级管理人员	528,500	0.22%	IPO前取得;377,500股其他方式取得;151,000股

上述减持主体无一致行动人。
注:2024年05月07日,公司于上海证券交易所网站披露了《斯达半导体股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》,显示兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)分别持有公司股份22,238,201股、599,204股、377,500股。2024年05月23日,公司实施了2023年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。前述3位减持主体在转增实施之前并未进行减持,因此转增后兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)的持股数量相应变更为31,133,481股、838,886股、528,500股。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
兴得利	1,640,000	0.69%	2024/5/29-2024/8/29	集中竞价交易	81.89	147,867,238.00	已完成	29,493,471	12.32%
戴志展	30,000	0.01%	2024/5/29-2024/8/29	集中竞价交易	93.61	2,965,740.80	已完成	807,886	0.34%
TANG YI(汤艺)	32,000	0.01%	2024/5/29-2024/8/29	集中竞价交易	96.50	3,084,000.00	已完成	496,500	0.21%

注:上述减持数量包括2023年年度权益分派以资本公积金转增股本方式取得的股份。具体而言,2024年05月23日,公司实施了2023年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,前述3位减持主体在转增实施之前并未进行减持,因此转增后兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)的持股数量相应变更为31,133,481股、838,886股、528,500股,兴得利、戴志展、TANG YI(汤艺)的减持计划数量相应变更为4,620,000股、126,000股、70,000股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否
(三)减持期间时间间隔,是否未实施减持 未实施 已实施

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(四)实际减持是否未达到减持计划披露减持数量(非比例) 未达到 已达到
(五)是否提前终止减持计划 是 否
特此公告。
斯达半导体股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-037

斯达半导体股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
2023年09月,中国证监会监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2023]3201号)核准公司非公开发行不超过1,600万股新股。

公司实际向J.P. Morgan Chase Bank, National Association, 富国基金管理有限公司, BAIKLAYS BANK PLC 等14位认购人合计发行人民币普通股股票10,606,060股,每股面值1.00元,发行价格330.00元/股,共计募集资金人民币349,999.98万元,扣除承销费用人民币2,200.00万元(含税)后的募集资金为人民币347,799.98万元,已于2023年11月03日全部到账。本次募集资金净额人民币349,999.98万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,304.93万元后,实际募集资金总额人民币347,695.05万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2023]第ZA15756号验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2024年06月30日,募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,499,999,800.00
减:发行费用	23,049,327.04
募集资金净额	3,476,950,472.96
项目累计投入	2,885,730,059.69
募集资金用于管理取得的理财收益	16,715,528.21
利息收入(不含手续费净额)	128,133,438.92
项目累计投入	604,976,699.69
募集资金用于管理取得的理财收益	0.00
利息收入(不含手续费净额)	1,842,289.40
截至2024年06月30日募集资金期末余额	32,889,025.11

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理的规定》(2022年8月15日)《证监会公告[2022]15号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。

2023年11月15日,公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年11月26日,嘉兴斯达微电子(以下简称斯达微电子)与公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年03月22日,为进一步提高募投项目的实施效率,更好保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》,公司新增募集资金专户账户并与相关方签署《募集资金监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,约定了与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行,不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日,公司募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	330404016000746187	活期	27,125,952.17
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	1931010402042587	活期	-
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	633749183	活期	1,217,505.44
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	193101040005016	活期	4,429,706.01
嘉兴斯达微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	330404016000749264	活期	39,765.54
嘉兴斯达微电子有限公司	中国民生银行	193101040033368	活期	64,028.39
嘉兴斯达微电子有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	33489991013000255187	活期	12,067.56
合计				32,889,025.11

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2024年1-6月,本公司实际使用2021年非公开发行股票募集资金人民币604,976,699.69元,具体情况使用详见附表1《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币16,088.32万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核,并出具了《专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZA10711号)。

上述自筹投入的自筹资金,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,独立董事、公司监事会、发表明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。信息披露情况请见公司于2022年04月08日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-013)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年04月28日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意为充分利用公司闲置资金,进一步提高闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,拟授权公司管理层使用额度不超过人民币300,000.00万元的暂时闲置资金和不超过300,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品,期限为股东大会审议批准之日起至下次有权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度内决议有效期内,可以滚动使用。

公司于2024年04月29日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意为充分利用公司闲置资金,进一步提高闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,拟授权公司管理层使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置资金和不超过150,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品,期限为股东大会审议批准之日起至下次有权机构批准作出新的决议前有效。上述额度在决议有效期内,可以滚动使用。

本年度,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司存在将募集资金由专户转入外汇结算户,再由外汇结算户进行外汇结算的情形,公司进行上述操作主要系相关人员根据实际交易流程,用外汇结算户购买海外设备,而上述外汇结算户中募集资金均已全部用于募投项目建设,每笔资金流向与设备购买匹配,不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。
斯达半导体股份有限公司
董事会
2024年08月30日
附件1:
2023年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:斯达半导体股份有限公司
2024年1-6月
单位:人民币元

募集资金总额	3,476,950,527.96	本年度投入募集资金总额	604,976,699.69
变更用途的募集资金总额	不适用		
变更用途的募集资金总额比例	不适用	已累计投入募集资金总额	3,590,752,739.38

承诺投资项目	已变更项目,有募集资金总额变动(如有)	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例(%)	截至期末累计投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差额(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	是否发生资产减值	项目可行性发生重大变化的说明
高硅特色工艺功率芯片研发及产业化项目	不适用	1,476,950,527.96	1,476,950,527.96	346,744,471.72	1,532,073,532.31	55,123,004.35	103.73	2024年11月	否	不适用
SiC芯片研发及产业化项目	不适用	500,000,000.00	500,000,000.00	177,266,150.26	558,619,779.39	58,619,779.39	111.72	2024年11月	否	不适用
功率半导体模块生产线自动化改造项目	不适用	700,000,000.00	700,000,000.00	80,966,077.71	699,041,324.40	- 958,675.60	99.86	2024年11月	否	不适用
补充流动资金	不适用	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	801,218,102.28	1,018,123.28	100.13	不适用	否	不适用
合计		3,476,950,527.96	3,476,950,527.96	604,976,699.69	3,590,752,739.38	113,802,231.42				

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明: 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况: 详见专项报告三.(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 详见专项报告三.(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况: 详见专项报告三.(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况: 不适用

募集资金结存余额及形成原因: 不适用
募集资金其他使用情况: 详见专项报告三.(八)募集资金使用的其他情况

注:承诺投资项目截至期末投入进度超100.00%,系使用募集资金用于资金管理取得的理财收益及利息收入资金。

公司代码:603290 公司名称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案为:以截至本报告期末总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

无
第二节 公司简介
2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所	公司注册地址	股票简称	变更前股票简称
A股	603290	上海证券交易所	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾跨海大桥南堍	603290	/

联系人及联系方式
姓名:董洁
电话:0573-8258 6699
办公地址:浙江省嘉兴市海盐县杭州湾跨海大桥南堍
电子邮箱:investor-relation@powersemi.com

2.2 主要财务数据
单位:元,币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,040,413,495.34	8,485,526,496.78	6.56
归属于上市公司股东的净资产	6,439,938,509.09	6,435,365,819.73	0.07
营业收入	1,533,106,679.90	1,687,940,407.47	-9.17
归属于上市公司股东的净利润	274,740,249.40	429,938,269.41	-36.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,947,241.48	410,347,046.86	-34.70
经营活动产生的现金流量净额	520,962,279.20	188,524,497.41	176.34

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-065

佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 下述担保无反担保,且属于2024年度预计担保范围内的担保事项,为2024年度预计担保事项的进展。

● 佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司及孙公司提供担保,其中,为广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)向中国工商银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称“工商银行海珠支行”)申请授信提供不超过23,010,678.90元的履约担保担保;为“广州新佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)、广州佳都技术有限公司(以下简称“佳都技术”)、广州佳都电子科技有限公司(以下简称“佳都电子”)向“广州银行股份有限公司广州分行(以下简称“广州银行广州分行”)申请授信提供合计不超过40,000万元的担保;为佳都技术向中国工商银行股份有限公司广州第三支行(以下简称“工商银行广州第三支行”)申请授信提供不超过1,000万元的担保;为新科佳都向中国工商银行股份有限公司广州东山支行(以下简称“工商银行东山支行”)申请授信提供不超过77,000万元的担保。

● 截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为36.96亿元,无逾期对外担保。

● 特别风险提示:本次被担保人广州新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司、广州佳都电子科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司截至2023年12月31日资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险。截至本公告日,公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为75.33亿元(包括银行授信担保金额67.68亿元、厂商信用担保7.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为36.96亿元(包括银行授信担保余额36.75亿元及厂商担保余额0.21亿元),担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为47.46%。

(一)担保概述
1. 本次担保事项

为满足公司全资子公司华之源综合授信需求,近日公司与工商银行海珠支行签署《保证合同》,公司拟为华之源与工商银行海珠支行签署的《借款合同》(编号为:440502200400170)提供担保,担保额度不超过23,010,678.90元,保证方式为连带责任保证,保证人的保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下不存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

为满足新科佳都、佳都技术及佳都电子的综合授信需求,近日公司与广州银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为上述三家子公司与广州银行广州分行签署的《授信协议书》(以下简称“主合同”)形成的债权债务提供担保,担保额度合计不超过40,000万元,其中,流动资金贷款合计不超过20,000万元。新科佳都可使用额度不超过20,000万元,佳都技术可使用额度不超过10,000万元。保证方式为连带责任保证,保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规或主合同及其项下单项协议约定的事项,甲方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。

为满足公司全资子公司佳都技术综合授信需求,近日公司与工商银行广州第三支行签署了《最高

额保证合同》,公司拟为佳都技术与工商银行广州第三支行签署的《借款合同》(合同具体包括:本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议等),开立担保协议、《国内贸易融资协议》及《远期结售汇协议》等金融衍生品协议,贵金属包括黄金、白银、铂金等贵金属质押借款合同以及其他合同)提供担保,担保额度不超过1,000万元,保证方式为连带责任保证,保证期间为银行授信协议分别计算,自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至借款合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需求,近日公司与工商银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司拟为新科佳都与中国工商银行分行签署的《授信额度协议》等形成的债权债务提供担保,担保额度不超过77,000万元,保证方式为连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(二)担保事项履行程序
本次担保事项属于2024年度预计担保额度范围内的担保。2024年度担保额度预计事项已经于2024年4月7日、2024年5月9日分别召开的第十届董事会第七次会议、2023年年度股东大会审议通过。

(三)被担保人基本情况
广东华之源信息工程有限公司为全资子公司,统一社会信用代码:91440001545523254C,成立日期:2003年9月26日,法定代表人:林超,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1701房,通信地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1701房,注册资本:25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通通信信号系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截至2023年12月31日总资产为304,698.81万元,总负债261,015.67万元,其中流动负债259,390.47万元,流动资金贷款6,000.00万元,归属于上市公司净资产61,460.84万元;2023年度营业收入362,360.90万元,营业利润16,622.34万元,归属于上市公司净利润13,625.13万元。截止至2024年6月30日总资产为541,129.63万元,总负债451,244.70万元,其中流动负债448,690.27万元,无流动资金贷款,归属于上市公司净资产89,663.40万元;2024年半年度营业收入214,438.07万元,营业利润8,815.57万元,归属于上市公司净利润7,288.28万元。

广州佳都技术有限公司为全资子公司,统一社会信用代码:91440101755594850F,成立日期:2004年1月7日,法定代表人:林超,注册地址:广州市天河区新塘路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化自动设备检测系统、屏显门系统、中央监控系统。截至2023年12月31日总资产为563,413.62万元,总负债475,931.11万元,其中流动负债473,087.62万元,流动资金贷款1,000.00万元,归属于上市公司净资产87,282.37万元;2023年度营业收入4,672,758.86万元,营业利润14,714.27万元,归属于上市公司净利润13,625.13万元。截止至2024年6月30日总资产为541,129.63万元,总负债451,244.70万元,其中流动负债448,690.27万元,无流动资金贷款,归属于上市公司净资产89,663.40万元;2024年半年度营业收入214,438.07万元,营业利润8,815.57万元,归属于上市公司净利润7,288.28万元。

广州佳都技术有限公司为全资子公司,统一社会信用代码:914401017955065498,成立日期:2006年10月31日,法定代表人:肖超,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1705房,注册资本:15,000万元人民币。佳都技术主要从事网络及云计算产品集成及服务业务。截至2023年12月31日总资产为137,161.59万元,总负债121,562.33万元,其中流动负债121,562.33万元,流动资金贷款1,000.00万元,归属于上市公司净资产15,599.26万元;2023年度营业收入283,701.22万元,营业利润182.71万元,净利润134.25万元。截止至2024年6月30日总资产为128,628.59万元,总负债112,846.22万元,其中流动负债112,846.22万元,无流动资金贷款,净资产15,782.38万元;2024年半年度营业收入99,934.65万元,营业利润126.13万元,净利润183.12万元。

广州佳都电子科技有限公司为全资子公司,法定代表人:李家涛,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房,通信地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1702房,注册资本:6,000万元人民币。佳都电子系公司于2023年8月11日成立的集中采购平台,承担公司各类项目的设备材料采购等。截至2023年12月31日总资产为123,282.45元,总负债117,649.17万元,其中流动负债117,277.60万元,流动资金贷款1,000.00万元,净资产563.38万元;2023年度营业收入104,696.76万元,净利润1,500.00万元,归属于上市公司净利润484.48万元。截至至2024年6月30日总资产为171,381.38万元,总负债165,145.27万元,其中流动负债164,785.6